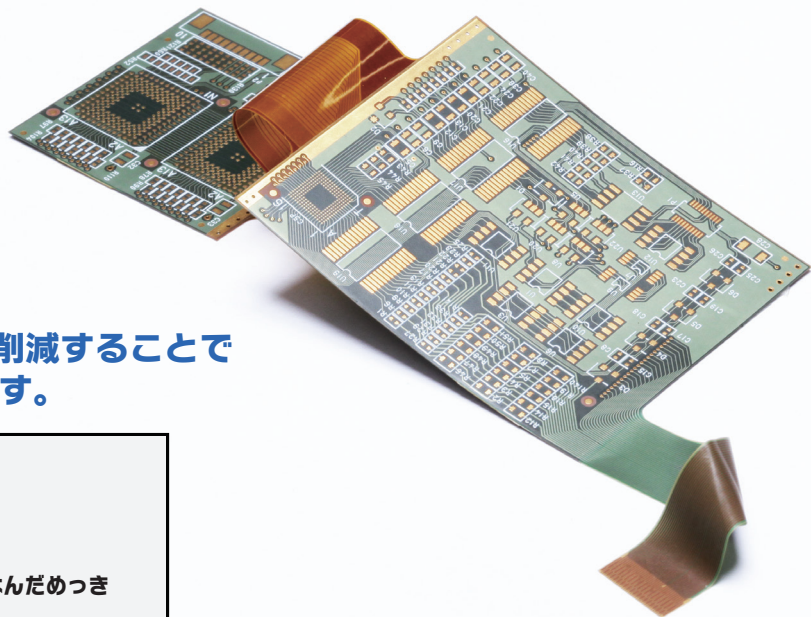


# 高速伝送用多層FPC

## 多層FPCで リジッドフレキと 類似機能！



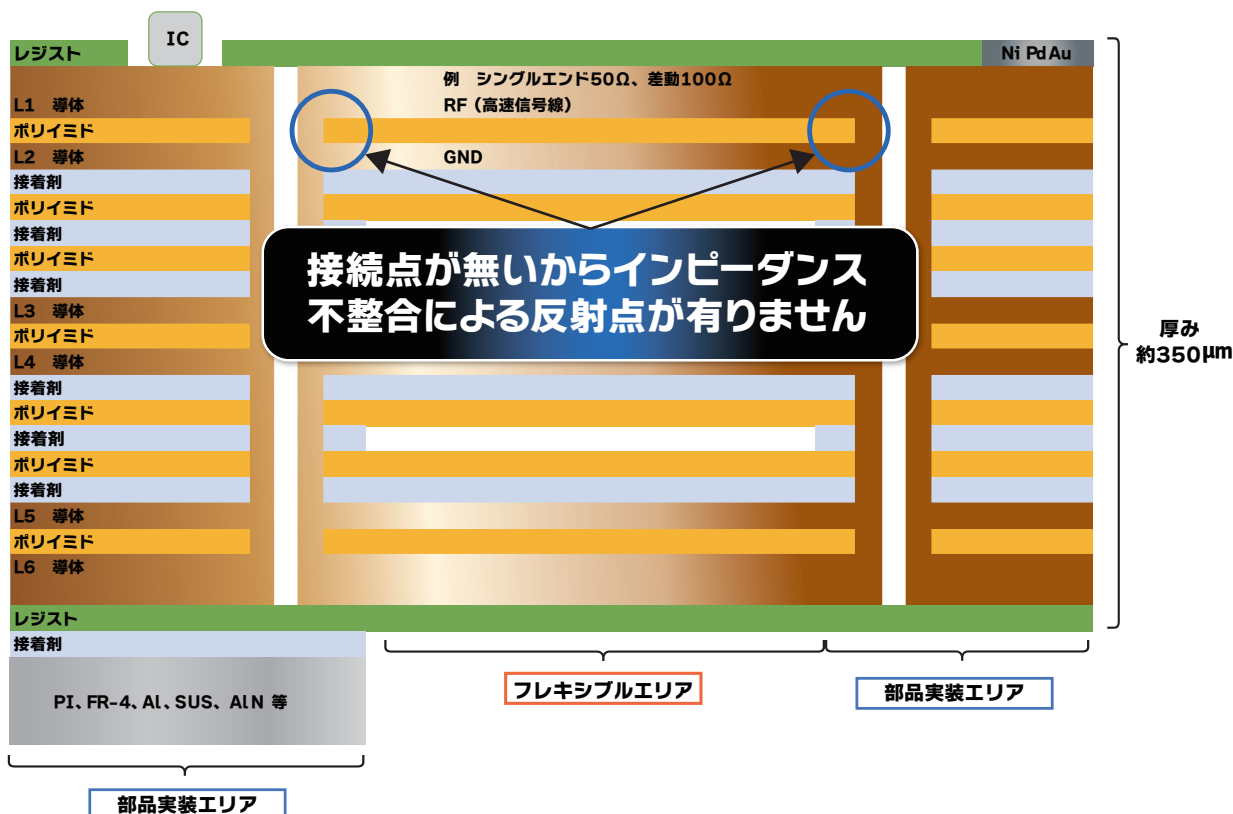
FPCとPCBの接続点が無く、反射点を削減することで  
数十Gクラスの高周波用途に適しています。

層数	: 3~8層
接続Via	: 貫通Via、ブラインドVia、フィールドVia
ベース材料	: ポリイミド、液晶ポリマー
FPC厚み	: 200~800 $\mu$ m程度
表面処理	: 金フラッシュ、ニッケルパラジウム金、鉛フリーはんだめっき

### 製品特徴

- 金属やセラミックスなどの補強板を付ける事で放熱対策が可能です。
- 高密度のRFラインにより小型化可能です。
- ワイヤボンディングに対応可能です。

### 層構造例



YAMASHITA MATERIALS